

证券代码：600641

证券简称：万业企业

## 上海万业企业股份有限公司

### 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会会议纪要

投资者关系活动类别	业绩说明会
参与对象	投资者
时间	2024 年 6 月 3 日 9:00-10:00
地点	上证路演中心
上市公司接待人员姓名	万业企业董事、总裁李勇军先生 万业企业董事刘荣明先生 万业企业独立董事 JAYJIECHEN（陈捷）先生 万业企业独立董事万华林先生 万业企业独立董事夏雪女士 万业企业副总裁江加如先生 万业企业副总裁兼董秘周伟芳女士 万业企业首席财务官邵伟宏先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>第一部分：公司情况介绍</p> <p>近年来，万业企业深度聚焦半导体集成电路设备领域业务板块，旗下目前拥有凯世通和嘉芯两家设备控股子公司，覆盖了离子注入机、刻蚀、薄膜沉积以及快速热处理等多个品类。2023 年，公司实现的营业收入 9.65 亿元，归母净利润 1.51 亿元。其中，集成电路专用设备制造业务实现销售收入 3.46 亿元，同比大幅增加 67.53%，公司面向集成电路领域战略转型取得明显成效。2024 年一季度，公司实现营业收入 9912.53 万元，扣非归母净利润 1281.97 万元，截止年报披露日凯世通交付首台面向 CIS 的大束流离子注入机，并向多家重复订单客户发货 8 台离子注入机设备，并在 4 月新增数台已有客户的重复订单。从营收结构来看，2023 年公司集成电路营业收入达 3.46 亿元，约占 36%，同时公司连续三年集成电路业务板块营收复合增长率达 41.18%。</p>

2023年起至年报披露日，公司旗下两大集成电路控股子公司凯世通和嘉芯半导体在本土主流晶圆厂国产线采购中均实现了销售业绩，累计获得集成电路设备订单约4亿元，其中凯世通约2.7亿元，嘉芯半导体约1.3亿元。两家公司自2020年以来累计获得的集成电路设备订单金额近17亿元。

2023年，凯世通、嘉芯半导体在技术升级、产品研发及市场拓展方面也都取得重大进展。其中凯世通作为国内离子注入机行业龙头，真正意义上实现28nm低能离子注入工艺全覆盖，并率先完成了国产高能离子注入机产线验证及验收。与此同时，凯世通基于正向设计和自主创新的理念，持续加大投入，坚持在细分领域，围绕主导产业，不断进行现有产品升级优化和关联新产品开发，攻关特色工艺以及卡脖子的机型，推出包括面向CIS的大束流注入机、中束流离子注入机、氢离子大束流注入机以及面向碳化硅的高温离子注入机等新产品，加速构建全系列离子注入机产品矩阵。2024年一季度，凯世通成功向客户交付了面向CIS的大束流离子注入机。此外，2023年，凯世通金桥和北京新基地的双核心启动，进一步夯实公司研发实力、客服水平、产能保障等综合竞争能力。

嘉芯半导体则是万业和重要国际知名专家联合创办的成熟制程设备平台。产品线现已涵盖CVD/PVD/刻蚀和快速热处理等多品类主要工艺设备等，致力于为客户打造一站式的设备解决方案。在技术研发上，嘉芯半导体自研的PHOEBUS PVD具备高精确性、灵活性，可满足客户多元化工艺需求，兼具12吋和8吋架构。此外，基于客户特殊工艺的需求，嘉芯耗时6到12个月开发深槽刻蚀工艺，将每个线宽的沟槽做到业界高标，长期重复性试验达到符合客户实际需求的工艺标准。

展望未来，随着后续行业景气持续回升以及国产化进程加快等多重积极因素的驱动，万业企业坚定聚焦研发投入，通过集成电路领域的整合，力求实现从量变到质变的飞跃。

## 第二部分：主要交流问答

Q：能否请董秘介绍一下公司 2023 年具体的营收情况和结构构成？

A：尊敬的投资者，您好！半导体产业作为新兴产业的核心支撑，是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量。近年来，万业企业深度聚焦半导体集成电路设备领域业务板块并持续深耕发力，2023 年公司实现营收 9.65 亿元；实现归属于上市公司股东的净利润 1.51 亿元；研发投入达到 1.63 亿元，同比增长约 50%。同时从具体营收结构来看，2023 年公司集成电路营收实现突破性增长，营收达到 3.46 亿元，同比增长 67.53%。2023 年至年报披露日，公司旗下凯世通及嘉芯半导体共获得集成电路设备订单约 4 亿元，2020 年起至年报披露日，两家公司累计集成电路领域订单金额达到约 17 亿元。感谢您的关注！

Q：请问领导 2024 年一季度公司的经营情况怎么样？

A：尊敬的投资者，您好！2024 年一季度，公司实现营业收入 9912.53 万元，扣非归母净利润 1281.97 万元，2024 年一季度凯世通交付首台面向 CIS 的大束流离子注入机，自一季度至年报披露日，凯世通以平均每月数台设备的速度向客户进行交付，向多家客户发货 8 台离子注入机设备。此外，自 2024 年 4 月起，公司获得已有客户的数台重复订单，再次实现批量重复采购，充分体现了客户对公司产品实力的青睐与认可。感谢您的关注！

Q：董秘您好，今年一季度公司净利润下滑的原因是什么？

A：尊敬的投资者，您好！2024 年一季度公司实现归属于上市公司股东的净利润 473.83 万元，利润下滑主要由于报告期内公司资金理财收益及持有的交易性金融资产公允价值较上年同期下降所致。此外，半导体领域属于典型的资金、技术密集型行业，具有较高的技术研发门槛，行业新技术、新产品研发投入较大，投资周期长，公司目前在半导体设备业务领域仍处于研发高投入期，这些因素综合导致了本期利润较上年同期减少。感谢您的关注！

Q: 领导您好, 2023 年第四季度, 为什么公司的净利润是负值?

A: 尊敬的投资者, 您好! 第四季度亏损的原因主要系公司收入主要集中在 1-9 月份, 占全年收入的 79%, 利润提前在前三季度体现; 另外第四季度受资本市场下行影响, 公司持有的交易性金融资产公允价值下降所致。感谢您的关注!

Q: 请介绍一下公司去年的研发费用情况?

A: 尊敬的投资者, 您好! 为了实现公司产品核心竞争力的进一步提升, 万业企业始终坚持加大研发的投入, 自 2016 年公司开启转型之路起, 公司的研发费用从最开始的百万元, 千万元增长到截止 2023 年末的 1.63 亿元, 同比增长超 50%, 致力于用扎实的研发成本砌出一道道厚重坚实的技术壁垒。

目前, 公司旗下凯世通已经形成了一系列具有自主知识产权的核心技术, 解决了高端芯片实际生产过程中面临的极低能量大剂量注入、高角度均匀性、颗粒污染控制、低能量注入能量污染、设备高产能等技术挑战。截至 2023 年年末, 公司累计申请专利 266 项 (其中发明专利 135 项), 已授权专利 198 项, 其中发明专利 97 项, 实用新型专利 93 项, 其他专利 8 项。公司拥有的技术实力为今后的发展提供了坚实的后盾, 是公司市场竞争力进一步提升的重要保障。感谢您的关注!

Q: 2023 年公司销售费用变动原因是什么?

A: 尊敬的投资者, 您好! 公司销售费用从 2022 年的 1304 万上升到 2023 年的 2731 万。销售费用变动原因主要系子公司凯世通因专用设备制造业务销售产品增加, 产品质保费用和售后服务费增加所致。感谢您的关注!

Q: 请问各位领导凯世通 2023 年的具体订单情况如何?

A: 尊敬的投资者, 您好! 公司重要控股子公司凯世通 2023 年度开拓

出多家 12 英寸晶圆厂新客户，多款离子注入机设备产品获得了重要晶圆厂客户的重复采购。2024 年一季度至年报披露日，凯世通向多家重复订单客户共计发货 8 台离子注入机设备，4 月起新增数台客户订单。自 2023 年至年报披露日，凯世通已生产、交付多款高端离子注入机系列产品，新增多家 12 英寸芯片晶圆制造厂客户，新增订单金额超 2.7 亿元，涵盖了逻辑、存储、功率、图像传感器等多个应用领域方向。近年来，凯世通一方面不断加大现有设备产品持续改进和新产品开发力度，低能大束流系列产品与高能离子注入机持续完善并不断迭代升级，工艺覆盖率、良率、产能置换率等综合性能表现持续优化，是实现 28nm 低能离子注入工艺全覆盖的国产供应商，并率先完成国产高能离子注入机产线验证及验收。与此同时，凯世通的设备在重点晶圆厂客户的量产产线上，其综合表现亦不断攀升，产品性能卓越，赢得了客户的高度认可。公司服务团队的高效与专业，更是为客户提供了全方位的保障，进一步巩固了凯世通在业界的良好口碑。感谢您的关注！

Q: 请问目前凯世通产能情况怎么样？

A: 尊敬的投资者，您好！目前，凯世通建设了上海金桥基地、上海临港基地、北京联东 U 谷基地等多处洁净车间制造基地；并建立了千级洁净标准的实验室，不仅为客户进行晶圆样片（wafer demo）提供了极大的便利；同时也为关键零部件的存储创造了适宜条件。凯世通在 2023 年多型号离子注入机设备被多家国内客户验证、签署批量复购订单。因此，公司已提早重视关键零部件的筹备，产能建设以及仓储空间租赁。金桥基地二期装修预计将于今年中期完成。凯世通目前无尘车间面积所对应的产能可以满足已有订单以及潜在客户的需求量。感谢您的关注！

Q: 请问领导，凯世通高能离子注入机产品商业化推进进程现在到哪一步了？

A: 尊敬的投资者，您好！在离子注入机方面，2022 年凯世通的

首台高能离子注入机已经完成了验收验证并且确认收入。2023 年一季度新增的 12 英寸晶圆厂客户，也和凯世通签署了高能离子注入机的订单。凯世通是目前全球极少能够向客户提供高能离子注入机设备的国产供应商之一。感谢您的关注！

Q: 请领导介绍一下凯世通目前的零部件国产化率情况。

A: 尊敬的投资者，您好！离子注入机作为半导体制造中不可或缺的前道核心设备，由数以万计的零部件构成，系统复杂度很高，涵盖了传动系统、高压电气系统、气体输送系统、真空系统等众多子系统。公司对于零部件供应商的选择十分慎重，对供应商的工艺经验、技术水平、商业信用进行严格考核，并对零部件进行严格测试。公司与核心零部件供应商已建立良好的合作关系，拥有稳定的供应商体系。同时，公司注重零部件的本土化，旗下凯世通从 2020 年着手离子注入机国产零部件的开发与验证工作，紧密结合国产半导体零部件发展情况，积极布局核心物料进口预防短期采购风险，逐步拓展单一零部件国产化与自制。公司积极自主加强部分核心零部件的国产化合作，持续有序地推进零部件国产化，确保供应链的安全健康和稳定，有力地保障了公司产品零部件供应和服务水平的持续提升。感谢您的关注！

Q: 关注到公司的新产品 CIS 离子注入机，请问这款设备的发展以及公司后续的研发方向？

A: 尊敬的投资者，您好！当前 CIS 市场进入了蓬勃发展的时期，手机多摄像头配置、汽车智能驾驶、VR/AR 可穿戴设备、智慧安防、机器视觉等新兴应用催生 CIS 市场不断壮大。根据 Yole 的数据分析，全球 CIS 市场的规模预计将从 2022 年的 213 亿美元增长至 2028 年的 290 亿美元，年复合增长率达到 5.1%。CIS 产品对金属污染与注入角度有很高的要求，凯世通的多项技术创新，满足了 CIS 对离子注入机的技术要求，并在 2024 年一季度推出自主研发用于 CIS 器件的低能大束流离子注入机，该产品于 2023 年第四季度收到客户订单，并于 2024 年

3月快速向客户进行交付。该产品是基于已批量验证的 iStellar 通用注入平台与光路系统，设备成熟稳定，同时具备卓越的金属污染控制、高精度注入角度控制等差异化优势。

后续，凯世通将进一步完善离子注入机的产品矩阵，保持细分领域内产品技术领先，包括其中 CIS 的大束流注入机、中束流离子注入机、氢离子大束流注入机以及面向碳化硅的高温离子注入机等。随着芯片制造工艺不断走向精密化，市场对于集成电路设备的性能提出了更高的技术要求。对离子注入而言，芯片设计的日益复杂，对离子注入机提出更高的技术要求，如高能量、高精度、高均匀度、低污染等，所需的离子注入工序亦相应增加。同时，芯片制程的升级也带来了新的掺杂需求，如 SOI、MEMS 等特殊工艺，这就需要开发新型的离子注入机来满足。

展望未来 2-3 年，公司将全力以赴，旨在实现全系列离子注入机的量产应用，包括中束流离子注入机、氢离子大束流注入机以及面向碳化硅的高温离子注入机等，以强化公司在本土半导体设备市场中的竞争力，持续迭代升级、优化现有设备和工艺，力求不断推出面向未来发展需求的新工艺、新设备。感谢您的关注！

Q: 请问各位领导凯世通去年启用了多个新生产建设基地，对产品的研发有哪些帮助？

A: 尊敬的投资者，您好！2023 年凯世通启用上海浦东金桥研发制造基地和北京联东 U 谷基地，增强了离子注入机系列产品的研发与产业化能力，提升了自身的研发实力、客服水平、产能保障等综合竞争力。作为新落成的产业化中心，凯世通金桥基地无尘车间与办公总面积超过 4400 平米，涵盖了技术研发、CIP 改进、零部件组装与验证、工艺验证、生产制造、客户培训等功能，并可向客户及合作伙伴提供低能大束流、超低温低能大束流、重金属低能大束流、高能离子注入机等全系列产品的评估，缩短从技术验证到客户导入的时间。感谢您的关注！

Q: 近年来凯世通发展得不错, 请问公司对凯世通后续技术服务升级和内部管理的提升有哪些方面的改造?

A: 尊敬的投资者, 您好! 凯世通金桥基地东侧即将投入使用, 将提供更多的研发机台工位, 研发工位将超过 10 个; 凯世通已经建立了服务研发部门的工程制造团队和为制造产业化设备的分工细致的专业化团队。凯世通在 2023 年进一步细化组织架构部门和科室, 设立了知识产权和法务部、供应链管理、EHS (环境、健康、安全) 部门、质量管理部, 这些工作不仅保证安全生产与合规运营, 还大幅提升了技术研发、生产制造、售后技术各个方面能力, 提高客户满意度。同时, 公司高度重视信息安全与保密工作, 按照客户信息安全的标准, 布局了信息安全系统, 保证公司网络安全与信息安全。后续, 公司也将逐步完善信息系统, 提高公司内部管理的效率。感谢您的关注!

Q: 请问各位领导镓芯现在的经营情况怎么样?

A: 尊敬的投资者, 您好! 2023 年浙江镓芯电子科技有限公司共计实现营业收入 6.72 亿元, 归母净利润 7649 万元, 相比 22 年同期有所下滑。主要因半导体行业大周期影响。24 年镓芯的主要任务是落实海外生产基地量产计划、同时开拓中国区业务。感谢您的关注!

Q: 2023 年楼市的行情波动对于公司房地产业务和公司业绩的影响大吗?

A: 尊敬的投资者, 您好! 公司房地产业务目前主要是存量房产的销售和经营, 已无新的住宅开发项目。目前存量房地产业务范围主要集中在上海及长三角区域。2023 年度, 公司房地产业务无新增土地储备, 无新开发的住宅项目, 依据公司经营方针, 以推动存量房和车位销售为主要目标。报告期内, 公司启动宝山 B2 项目剩余住宅及无锡地下车位销售。在公司销售部门和其他部门通力合作下, 对房产市场形势判断准确, 和市场抢时间, 加快销售进度, 宝山 B2 项目住宅和无锡地下车位

在 2023 年上半年即已基本完成全年度销售目标，避免了 2023 年房地产市场下行、量价逐渐下跌的不利局面。感谢您的关注！

Q: 希望领导能给我们 2024 年公司房地产业务的销售节奏？

A: 尊敬的投资者，您好！2024 年度公司的房地产业务依然是按照去库存化进行规划，已无新增土储，存量房产已经进入收尾阶段。公司主要资产集中在上海及长三角区域，因为前期开发投入较少具有很大的成本优势。这对于公司的房地产业务和半导体行业转型提供了良好的财务基础。感谢您的关注！

Q: 2024 年全球范围半导体行业复苏迹象明显，请问公司对 24 年晶圆厂扩张的节奏是怎么看待的，对公司发展有何影响？

A: 尊敬的投资者，您好！从 SEMI 近期公开的数据来看，在行业经历了 2023 年的收缩后，2024 年全球半导体设备市场规模有望迎来复苏并增长至 1053.1 亿美元。SEMI 提到，中国将引领半导体行业扩张，预计中国将增加其在全球半导体产能中的份额，并在 2024 年产能同比增加 13%。从公司现状看，凯世通设备在重点晶圆厂客户的量产产线上的综合表现持续提升，产品设备卓越的性能表现与服务团队高效专业的服务能力助力凯世通高端离子注入机系列产品在 2023 年度开拓出多家 12 英寸晶圆厂新客户，多款离子注入机设备产品获得了重要晶圆厂客户的重复采购。公司目前也在积极推进与晶圆厂客户的接洽，争取相关订单落地。感谢您的关注！

Q: 2024 年公司的发展战略是什么？

A: 尊敬的投资者，您好！2024 年万业企业将持续战略布局半导体设备材料赛道，通过“外延并购+产业整合”双轮驱动，持续打造“1+N”的平台模式，同时根据市场动态和客户需求，利用现金储备优势，围绕集成电路制造工艺拓展业务品类，在完善工艺链条的同时，努力实现上下游产业链协同，深化构建半导体核心设备领域竞争力，推动平

台产品矩阵的进一步完善及产业稳步延伸发展，力求带来订单和收入利润的新突破，更好地回馈广大股东和投资者。感谢您的关注！

Q：公司如何看待这几年半导体行业的发展情况？

A：尊敬的投资者，您好！当前全球新一轮的科技革命正在兴起，以5G通信、人工智能、物联网、云计算以及新能源汽车为代表的技术产业化应用，将推动产业变革加速演进。半导体产业作为新兴产业的核心支撑，是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量。2023年，半导体行业整体处于周期下行—底部复苏阶段，根据SEMI发布的数据，预计2024年全球半导体制造业有望开启复苏，其中全球半导体设备规模有望达到1053.1亿美元，同比增长4%，晶圆制造设备销售额有望达到931.6亿美元，同比增长3%。

集成电路设备作为贯穿半导体全产业链的技术先导者，是半导体产业发展的基础和关键支撑。近年来集成电路设备行业表现出较高的增长态势，但现阶段受下游晶圆厂以及存储器厂商产能利用率下滑，同时叠加高库存水平影响，产业的周期性调整趋势逐步传导至上游半导体设备行业。中商产业研究院分析，2023年全球半导体硅片出货面积将达到152.6亿平方英寸。根据SEMI在SEMICON Japan 2023上发布的《年终总半导体设备预测报告》，预计半导体制造设备将在2024年恢复增长，在前端和后端市场的推动下，2025年的销售额预计将达到1240亿美元的新高。

近年来，我国集成电路产业发展外部环境愈发复杂，然而这也带来了前所未有的机遇，促进了半导体设备国产化率的提升。基于当前国际、国内市场现状以及技术发展趋势，半导体设备核心技术独立性和自主可控紧迫性愈加凸显，实现集成电路产业高质量发展，需要半导体设备厂商不断加强技术创新，推动设备向高精度化与高集成化方向发展，并逐步完善半导体产业链，最终实现上下游行业协同发展，共享共赢。面对这些发展机遇和挑战，公司将进一步巩固和提升竞争优势，继续优化经营管理，持续开拓市场，为长远发展做好规划和积淀，努

力为股东创造价值。感谢您的关注！

Q: 公司的研发和专利情况较上年有什么变化？

A: 尊敬的投资者，您好！公司始终保持较高的研发投入增速，2023年研发投入达1.63亿元，研发投入同比增长约50%。截至2023年末，公司累计申请专利266项（其中发明专利135项），已授权专利198项，其中发明专利97项，实用新型专利93项，其他专利8项。公司拥有的技术实力为今后的发展提供了坚实的后盾，是公司市场竞争力进一步提升的重要保障。感谢您的关注！

Q: 国九条新政策发布后，各界极为关注上市公司分红的问题，公司在分红方面有计划吗？

A: 尊敬的投资者，您好！公司秉承“以投资者为本”的上市公司发展理念，积极响应监管层多举措引导上市公司现金分红的号召，积极采纳新“国九条”关于鼓励上市公司现金分红的精神。公司2023年度利润分配预案拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为30.32%。公司2020年、2021年、2022年年度累计分配利润超过3亿元，彰显万业企业积极履行上市公司责任，贯彻落实“提质增效重回报”理念。感谢您的关注！

Q: 半导体行业公司格外注重人才的培养，请问公司在这方面有什么考虑？

A: 尊敬的投资者，您好！万业企业在强化半导体产业链条的同时，也在积极投入加大对半导体专业人才链的投资。2023年度，公司结合业务发展需要，持续加强人才梯队建设，公司人数从585人增长到618人，其中研发人员人数从130人增长到157人，研发人员人数增长率为20.78%。

在人才引进方面，公司进一步拓宽人才吸引渠道，从国内外吸引了行

业经验丰富的管理及技术人才，为公司战略发展注入新动能。

在人才培养方面，公司持续优化培训体系，组织开展多项深入的专题培训、学习交流，充分发挥绩效考核激励机制，增强员工的荣誉感和凝聚力。公司旗下凯世通自 2022 年第四季度建立了人才种子计划，着手培养不同层面的技术和管理干部，并聘请管理咨询公司在公司开展多场干部培训。公司旗下嘉芯半导体自 2023 年 8 月与嘉善复旦研究院签订了战略合作协议，双方将联合加大科研投入，共筑人才高地，推动产学研深度融合。

同时，为了充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高员工的凝聚力和公司竞争力，促使相关员工利益与公司长远发展更紧密地结合，23 年公司完成员工持股计划第二次预留份额全部分配，参与公司本次员工持股计划的人数共计 151 人。经审计，2023 年公司集成电路业务收入为 3.46 亿元，较 2022 年公司集成电路业务收入 2.06 亿元的增长率为 68%，预留授予部分业绩考核指标已顺利达成，符合解锁条件。公司不断促进人才队伍的建设和稳定，助力公司长远发展。

目前，公司已建成一支由国内外资深半导体技术与运营管理专家引领的有梯队、有层次的研发团队，成员专业知识与工程经验储备深厚，是公司自主创新与产业化能力的基石。公司的研发技术团队结构合理，分工明确，专业知识储备深厚，产线验证经验丰富，是奠定公司技术实力的基石。同时，公司会根据客户不同的工艺应用需求，持续完善量产产品功能。公司研发、工程与应用各职能间深度融合，产品端与市场端无缝衔接，进一步保障公司产品和服务的创新改进及市场竞争力。

未来公司将进一步吸引产业内的优秀人才，充实业界一流的公司研发团队，持续为客户提供满足技术要求的设备与工艺解决方案。感谢您的关注！

Q：去年公司集成电路的订单今年一季度以来情况怎么样？24 年的工

作目标和营收预期？

A：尊敬的投资者，您好！2023年公司新增多家客户订单，产品性能和技术实力已经获得已有客户和新客户的认可，同时公司成功实现了批量重复订单，具有重大意义。未来公司将继续保持技术先进性，着眼市场开拓，抓好市场占有率，管理注重“效益”和“质量”。2024年至年报披露日，凯世通已向多家客户发货8台离子注入机设备，并和已有客户新签了数台重复订单。公司目前也在积极推进与多家晶圆厂客户的接洽，争取相关订单尽快落地。同时，公司还在开拓零部件和离子注入机服务销售业务，培养新的收入增长点。感谢您的关注！